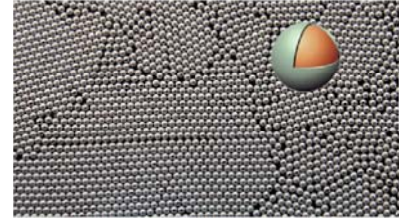


3Dパッケージに夢のイノベーションを

Dreamlike innovation for 3D packaging

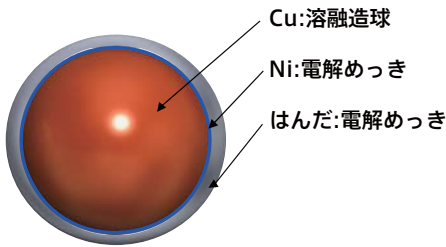
特長

- 3D実装でのスタンドオフを確実に確保
- 狭球系公差と高真球度を誇り、高信頼性3D実装を実現
- 高速伝送とエレクトロマイグレーション対策をお約束

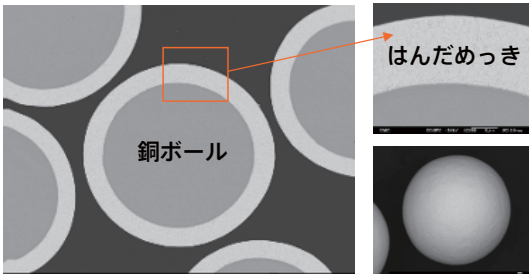
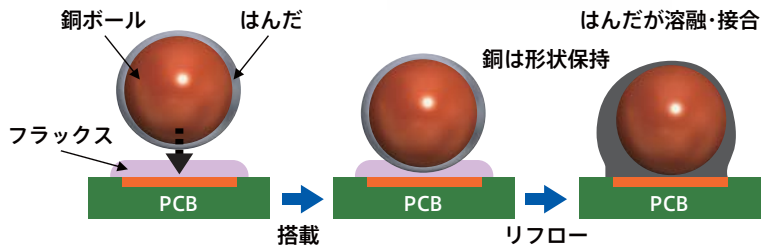


製品仕様

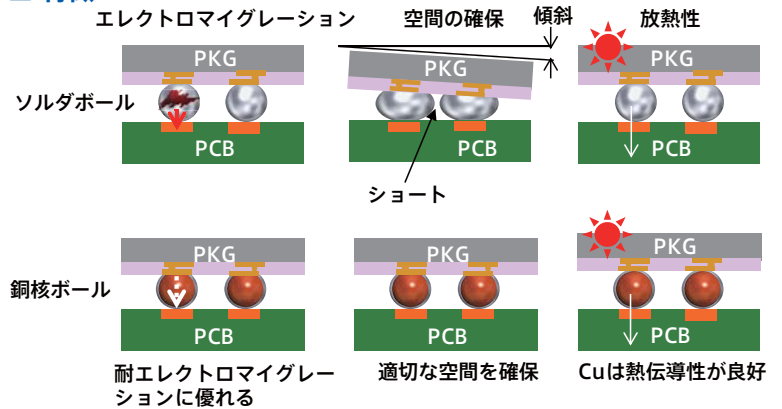
□ Cu核ソルダボールで空間確保と狭ピッチ化を解決



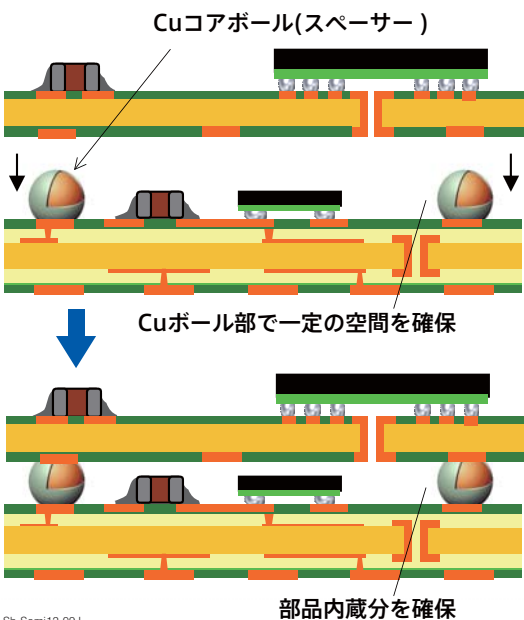
□ はんだ部で接合し銅ボール部で一定の高さを確保



□ 特徴



□ Cu核ボールで3D実装を容易に



Sh-Semi12-09J

□ シェア強度は、BGAソルダボールと同一

